

应用示例

焊接杯子、碗、盘子和泡形罩

塑料焊接

金属焊接

切割

清洗

筛分



任务设置

由塑料或带塑料涂层的铝箔制成的深冲式包装容器，如喷嘴、杯子、碗等，应在装填后用薄膜密封。密封区中可能存在的填充材料不得影响密封质量。

解决方案

针对该应用使用扭转式 SONIQTWIST® 超声波技术。根据包装单元的大小，可选择具有相应焊接力和功率的不同焊接设备。模块化 MAG 电箱可集成到台式设备或全自动生产系统中。工艺控制系统 TCS5 采用直观的图形化界面，操作十分简便，可提供多种质量保障选项。

该配置的优点

与传统的超声波技术相比，扭转式 SONIQTWIST® 工艺不会使待焊接的薄膜承受垂直振动，因此可避免出现薄膜效应而造成薄膜损坏。可能被填充材料污染的密封区因超声波振动而得到清洁，所以能够可靠焊接。采用最先进的总线系统将 MAG 电箱接入特殊设备，从而可对焊接参数进行调整并可实时读取结果。



该应用通过集成在具有总线连接的全自动化装填和密封设备中的模块化超声波组件实现。